

# 导热复合粉 Thermal conductive powder

TFP系列 TFP Series >>>

## 产品介绍 Product Introduction

导热复合粉能够在胶黏剂中构建完整的导热通路，赋予胶粘剂良好的散热特性，也可服务终端，在一些电子元器件，发热原件上提供新的散热解决方案

## 产品特点 Product Features

- 色相白
- 流动性好
- 热储存稳定
- 导热性能优良

## 产品参数 Product parameters

产品型号	平均粒径 (um)	吸油值 (g/100g)	外观	105°C挥发物%
TFP-100Y	18.34	8.6	白色粉末	0.33
TFP-150Y	9.29	10.2	白色粉末	0.35
TFP-200Y	12.55	13.4	白色粉末	0.31

(以上数据仅供参考，详细数据结果请联系我司销售人员获取确认)

## 应用数据 Application data

制备1.0~2.3W/(m.K)有机硅导热灌封胶，单位质量份

实验组	添加量	150cs 乙烯基硅油	含氢硅油	抑制剂	Pt催化剂
TFP-100Y	280~330	100	18.5	0.03	0.3
TFP-150Y	450~580	100	18.5	0.03	0.3
TFP-200Y	650~750	100	18.5	0.03	0.3

根据上表中组分配比打样制备灌封胶料，并在100°C下，5min加热硫化得到样片（2mm），测试样片相关应用数据如下

实验组	表现状态	流动性 (15cm)	黏度 (mPa.s)	导热系数 W/(m.K)	阻燃级别	密度 (g/cm3)	硬度A
TFP-100Y	乳白色	3s	3403	1.10	V-0	1.62	68
TFP-150Y	乳白色	7s	6426	1.58	V-0	1.71	69
TFP-200Y	乳白色	10s	8655	2.03	V-0	2.17	72

(以上数据仅由我司应用配方和实验条件所得，具体实验结果依据客户实际操作效果为准)

## 应用领域 Application area

- 环氧体系
- 聚氨酯体系
- 有机硅体系

## 备注 Remarks

- 导热系数要求和黏度要求若需调整，需测试样品反馈数据与我司相关人员沟通后，就测试方式和应用实验条件确保一致，根据贵司相关需求调整我司导热复合粉工艺及配比
- 若出现储存稳定性相关问题，50°C热储条件下30d出现底部板结，我司会就相关样品做复合处理，与贵司沟通后平衡黏度和储存稳定性之间的关系

广东海科新材料科技有限公司

Guangdong Hico New Materials Technology Co., Ltd

电话:0755-84696606 传真:0755-54696656

网址: www.hayond.com



扫码了解更多